

2026-2031年中国芯片制造行业全景调研及发展前景预测研究报告

报告简介

芯片制造是半导体产业中游核心环节，指在晶圆基底上通过光刻、刻蚀、沉积等一系列精密工艺完成集成电路的加工制造，是衔接芯片设计与封测的关键产业板块，产品覆盖逻辑芯片、存储芯片、功率芯片等各类晶圆制品，产业链涉及半导体设备、光刻胶、特种气体、靶材等上游材料与装备供应，下游支撑消费电子、汽车电子、工业控制、通信、人工智能等众多数字产业，是现代信息产业的基石。

当前国内芯片制造行业处在自主化能力持续建设的阶段，产业政策、市场需求与资本投入共同驱动产业能力稳步提升。国内晶圆制造主体类型多元，既有持续扩产的本土晶圆厂，也有依托国内市场布局的外资制造企业。行业发展过程中，高端工艺研发、核心配套供应链建设仍是产业发展重点，市场需求结构伴随下游产业转型不断调整，行业整体在实践中完善工艺体系、质量管控与配套协同能力。未来，国内芯片制造行业呈现工艺差异化发展、产业链协同深化以及应用导向定制化制造的发展趋势。先进工艺持续探索迭代的同时，成熟特色工艺成为产业落地的重要方向，面向功率器件、模拟芯片、车规芯片等领域的特色产线加速布局；上下游企业联动加强，推动国产设备材料在产线中持续验证导入，制造服务模式也逐步向为设计企业提供一体化晶圆代工方案转型。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及芯片制造行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国芯片制造行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外芯片制造行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了芯片制造行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于芯片制造产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国芯片制造行业发展

规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。

报告目录

第一章 芯片制造行业概述

第一节 行业定义与研究边界

一、行业核心定义

二、研究范围界定

三、行业统计口径说明

第二节 芯片制造工艺流程

一、晶圆制备环节

二、前道制造工艺

三、后段衔接流程

第三节 行业基本特征

一、资本密集特征

二、技术迭代特征

三、长周期投产特征

第二章 研究思路与研究方法

第一节 研究思路与报告框架

一、研究逻辑框架

二、数据采集思路

三、预测模型设计

第二节 研究方法体系

一、定量分析方法

二、定性研判方法

三、交叉验证方法

第三节 报告假设与局限说明

一、基础假设条件

二、数据局限性说明

三、预测边界说明

第三章 全球芯片制造产业发展态势

第一节 全球芯片制造产业发展历程

一、产业萌芽阶段

二、产业转移阶段

三、产能区域重构阶段

第二节 全球芯片制造市场规模分析

一、2024-2026年全球市场规模

二、产能总量结构分析

三、区域产能分布格局

第三节 全球芯片制造产业发展趋势

一、产能本地化趋势

二、工艺分化发展趋势

三、制造模式演变趋势

第四章 中国芯片制造产业链深度剖析

第一节 产业链整体结构

一、上游支撑环节

二、中游晶圆制造核心环节

三、下游应用承接环节

第二节 上游配套产业分析

一、半导体材料配套体系

二、半导体设备配套体系

三、配套环节供需匹配关系

第三节 下游应用需求结构

一、算力芯片制造需求

二、功率芯片制造需求

三、通用模拟芯片制造需求

第五章 中国芯片制造行业市场规模分析

第一节 国内行业总量规模

一、2024-2026年市场营收规模

二、晶圆产能总量统计

三、产能利用率指标分析

第二节 细分市场规模结构

一、按制程节点规模拆分

二、按产品类型规模拆分

三、按制造模式规模拆分

第三节 市场供需平衡分析

一、供给端产能变化

二、需求端总量变化

三、供需缺口测算

第六章 芯片制造行业细分市场研究

第一节 先进制程芯片制造市场

一、市场基本概况

二、产能供给现状

三、需求结构特征

第二节 成熟制程芯片制造市场

一、市场基本概况

二、产能供给现状

三、需求结构特征

第三节 特色工艺芯片制造市场

一、市场基本概况

二、产能供给现状

三、需求结构特征

第七章 中国芯片制造区域产业格局分析

第一节 国内产业集群分布概况

一、集群形成基础

二、集群空间分布特征

三、集群发展差异化特征

第二节 重点产业集群发展现状

一、长三角芯片制造集群

二、环渤海芯片制造集群

三、粤港澳芯片制造集群

第三节 区域产能竞争对比

一、各区域产能规模对比

二、各区域工艺能力对比

三、各区域配套能力对比

第八章 芯片制造行业技术发展分析

第一节 行业主流技术体系

一、微缩制程技术体系

二、特色工艺技术体系

三、晶圆制造工艺技术体系

第二节 技术迭代现状分析

一、先进制程技术进展

二、成熟工艺优化进展

三、新材料融合技术进展

第三节 中长期技术演进方向

一、工艺创新方向

二、架构融合方向

三、制造降本技术方向

第九章 芯片制造行业供需与价格分析

第一节 行业供给分析

一、在建产能统计

二、规划产能统计

三、产能释放节奏分析

第二节 行业需求分析

一、存量市场需求

二、增量市场需求

三、需求周期波动特征

第三节 晶圆代工价格走势分析

一、不同制程价格变化

二、价格影响因素分析

三、价格周期预判

第十章 芯片制造行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构

一、市场集中度测算

二、竞争梯队划分

三、行业竞争核心要素

第二节 行业竞争五力模型分析

一、供应商议价能力

二、下游客户议价能力

三、行业潜在进入威胁

四、行业替代品威胁

五、行业内部竞争程度

第三节 国内产能竞争态势

一、产能扩张竞争

二、工艺能力竞争

三、客户资源竞争

第十一章 重点企业深度分析

第一节 中芯国际集成电路制造有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争能力

四、经营发展动态

第二节 上海华虹(集团)有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争能力

四、经营发展动态

第三节 华润微电子有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争能力

四、经营发展动态

第四节 士兰微电子股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争能力

四、经营发展动态

第五节 长鑫存储技术有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争能力

四、经营发展动态

第六节 长江存储科技有限责任公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争能力

四、经营发展动态

第七节 立昂微电子股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争能力

四、经营发展动态

第八节 粤芯半导体技术股份有限公司

一、企业概况

二、主营产品与产能布局

三、核心竞争能力

四、经营发展动态

第九节 三安光电股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、主营产品与产能布局
- 三、核心竞争能力
- 四、经营发展动态

第十二章 芯片制造行业投融资分析

第一节 行业投融资概况

- 一、投融资总量变化
- 二、投融资结构特征
- 三、投融资主体类型

第二节 行业投资模式分析

- 一、新建产线投资模式
- 二、产能技改投资模式
- 三、并购整合投资模式

第三节 行业退出路径分析

- 一、资本市场退出路径
- 二、股权转让退出路径
- 三、资产整合退出路径

第十三章 芯片制造行业风险识别与评估

第一节 技术层面风险

- 一、技术迭代风险
- 二、工艺良率风险

三、研发投入风险

第二节 市场层面风险

一、需求周期波动风险

二、产能过剩风险

三、客户集中风险

第三节 运营层面风险

一、资本开支压力风险

二、人才供给风险

三、供应链波动风险

第十四章 2026-2031年中国芯片制造行业市场预测

第一节 行业总体指标预测

一、市场营收规模预测

二、晶圆总产能预测

三、产能利用率预测

第二节 细分市场预测

一、先进制程市场预测

二、成熟制程市场预测

三、特色工艺市场预测

第三节 区域市场发展预测

一、长三角产能增长预测

二、环渤海产能增长预测

三、粤港澳产能增长预测

第十五章 2026-2031年行业发展趋势预判

第一节 产业结构发展趋势

一、产能结构演变趋势

二、企业梯队演变趋势

三、产业链协同趋势

第二节 技术发展趋势

一、工艺融合发展趋势

二、制造智能化趋势

三、新型器件制造趋势

第三节 商业模式发展趋势

一、代工服务模式升级

二、制造与设计协同模式

三、定制化制造模式

第十六章 行业发展策略与投资建议

第一节 行业发展策略建议

一、产能布局策略

二、技术研发策略

三、产业链协同策略

第二节 行业投资机会研判

一、产能建设投资机会

二、工艺升级投资机会

三、配套协同投资机会

第三节 投资决策建议

一、投资进入时机建议

二、投资赛道选择建议

三、风险管控建议

图表目录

图表：芯片制造行业产业链结构

图表：芯片制造核心工艺流程示意图

图表：2024-2026年全球芯片制造市场规模变化

图表：2024-2026年全球晶圆产能区域分布

图表：2024-2026年中国芯片制造行业营收规模统计

图表：2024-2026年国内晶圆产能总量及产能利用率变化

图表：中国芯片制造细分市场规模结构(按制程)

图表：国内芯片制造产业集群空间分布

图表：国内三大产业集群产能对比

图表：芯片制造行业市场集中度(cr3/cr5)变化趋势

图表：芯片制造行业波特五力模型示意图

图表：国内主要芯片制造企业产能对比

图表：2024-2026年芯片制造行业投融资规模变化

图表：芯片制造行业风险矩阵评估图

图表：2026-2031年中国芯片制造市场营收规模预测

图表：2026-2031年国内晶圆产能总量预测

图表：2026-2031年芯片制造细分市场规模预测对比

图表：2026-2031年国内重点区域产能增长预测

图表：芯片制造行业技术路线演进图

图表：芯片制造行业投资机会热力图

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：4069764

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20260918/4069764.shtml>

在线订购：[点击这里](#)